

新洁能：巩固国内领先地位 加快成为国际一流半导体功率器件企业

——无锡新洁能股份有限公司首次公开发行 A 股网上投资者交流会精彩回放

出席嘉宾

无锡新洁能股份有限公司董事长、总经理
无锡新洁能股份有限公司董事会秘书

朱袁正先生
肖东戈先生

平安证券股份有限公司投资银行事业部执行总经理、TMT 行业组行政负责人、保荐代表人
平安证券股份有限公司投资银行事业部执行总经理、保荐代表人

陈拥军先生
盛金龙先生

无锡新洁能股份有限公司 董事长、总经理朱袁正先生致辞



尊敬的各位嘉宾、投资者、网友朋友们：

大家好！
我们非常高兴有机会通过网络平台，就无锡新洁能股份有限公司首次公开发行股票并在主板上市网上路演活动进行即时的网上交流。首先，我谨代表公司董事会、管理层以及全体员工，向长期关心、支持新洁能的各位投资者和各界朋友表示衷心的感谢！同时感谢上证路演中心、中国证券网为我们提供了这个沟通交流的平台。希望通过今天的交流，大家对新洁能有一个更深入的了解！
公司成立于 2013 年 1 月，专业从事

MOSFET（金属-氧化物半导体场效应晶体管）、IGBT（绝缘栅双极型晶体管）等半导体芯片和功率器件的研发设计及销售。公司是专业化垂直分工厂商，芯片主要由公司设计方案后交由芯片代工企业进行生产，功率器件主要由公司委托外部封装测试企业对芯片进行封装测试而成。公司已初步完成部分先进封装测试生产线的建设，将部分芯片自主封装成品后对外销售。公司产品系列齐全，广泛应用于消费电子、汽车电子、工业电子以及新能源汽车/充电桩、智能装备制造、物联网、光伏新能源等领域。自 2016 年以来，公司连续 4 年名列中国半导体行业协会发布的“中国半导体功率器件十强企业”，为国内领先的半导体功率器件设计企业之一。

希望通过今天的交流，各位投资者能充分了解新洁能的过去、现在和未来，并给予新洁能更多的关注和支持。我们坚信，在广大投资者高度信任和大力支持下，新洁能的发行工作必将圆满完成。

最后，再次感谢投资者朋友、社会各界对新洁能的关心，你们的积极参与，就是对我们最大的支持与鼓励。我们一定会用良好的业绩来回馈广大投资者、回报社会！谢谢大家！

平安证券股份有限公司 投资银行事业部执行总经理、 TMT 行业组行政负责人、保荐代表人 陈拥军先生致辞



尊敬的各位嘉宾、各位投资者和网友朋友们：

大家好！
首先，我谨代表平安证券股份有限公司，对所有参与无锡新洁能股份有限公司首次公开发行 A 股网上路演的嘉宾和投资者表示热烈欢迎！

作为新洁能的保荐机构及主承销商，我们深感荣幸。在与新洁能合作过程中，我们见证了公司在发展过程中取得的骄人业绩，也亲身感受到了公司管理层高效务实的执行力、深厚的专业能力和高瞻远瞩的战略眼光。此次迈入资本市场，相信新洁能必将抓住这一历史性机遇，进一步增强盈利能力和综合竞争力，为投资者带来丰厚的投资回报。

平安证券将切实履行保荐义务，勤勉尽职，做好持续督导工作。我们真诚地希望，通过本次网上路演推介活动，广大投资者能够更加深入地了解新洁能，从而更准确地把握新洁能的投资价值和投资机会！我们相信，新洁能够通过自己脚踏实地的不懈努力，给广大投资者交出一份满意的答卷，以优良业绩回报股东、回报社会、回报投资者。

最后，预祝无锡新洁能股份有限公司首次公开发行 A 股网上路演圆满成功！谢谢大家！

无锡新洁能股份有限公司 董事长、总经理朱袁正先生致结束词



尊敬的各位嘉宾、各位投资者和网友朋友们：

大家好！
今天的网上交流即将结束，感谢广大投资者的热情关注和踊跃提问，同时也感谢上证路演中心、中国证券网所提供的交流平台和良好服务，感谢平安证券以及所有参与发行的中介机构所付出的辛勤劳

动。在本次网上路演即将结束之际，我代表无锡新洁能股份有限公司，再次感谢各位的热情参与！

今天，各位投资者朋友从各个方面与我们进行了交流，大家提出了很多宝贵的意见和建议，我们将予以认真听取和吸收，努力提升自身的经营管理水平，创造出更好的业绩来答谢大家的关心与厚爱。

通过与大家的沟通，我们深深体会到作为一家公众公司的使命、责任和压力。步入上市公司行列后，我们将面临更多投资者的关注、关心与监督，这也将是新洁能继续做大、做强、健康发展的有力保障。

由于时间关系，我们无法一一回答投资者提出的每一个问题，但新洁能与投资者之间的沟通交流是持续和畅通的。欢迎大家通过电话、信件、电子邮件等各种方式与我们随时保持联系，也欢迎大家来新洁能进行实地考察。

最后，再次感谢广大投资者及各位网友对新洁能的支持和关心，祝大家投资顺利、万事如意！谢谢大家！



经营篇

问：公司的主营业务是什么？

朱袁正：公司的主营业务为 MOSFET、IGBT 等半导体芯片和功率器件的研发设计及销售。公司是专业化垂直分工厂商，芯片主要由公司设计方案后交由芯片代工企业进行生产，功率器件主要由公司委托外部封装测试企业对芯片进行封装测试而成。公司已初步完成先进封装测试生产线的建设，将部分芯片自主封装后对外销售。报告期内，公司主营业务未发生重大变化。

问：公司拥有多少子公司和分公司？

肖东戈：截至招股书签署日，公司拥有新洁能香港、电基集成 2 家全资子公司，以及新洁能深圳分公司、新洁能宁波分公司 2 家分公司，无参股子公司。

问：公司拥有多少专利权以及商标权？

朱袁正：截至 2020 年 1 月 19 日，公司拥有 97 项专利。其中，发明专利 35 项、实用新型 59 项、外观设计 3 项。截至目前，公司拥有 12 项商标权。

问：公司拥有哪些核心技术？

朱袁正：公司拥有完整的研发体系，核心技术来源于自主研发。公司已形成了包括屏蔽栅功率 MOSFET、超结功率 MOSFET、IGBT 工艺技术等多项共计 11 项核心技术。

问：请介绍公司的研发模式。

朱袁正：公司研发部门根据行业发展趋势、市场分析以及客户需求，确定研发规划和具体措施，通过组织公司各部门进行立项评审，确定产品开发项目。公司的产品开发需要经过技术研究和产品设计过程，其中技术研发流程包括客户需求评估、器件结构研究、工艺流程/单项工艺研究、电学特性研究等主要步骤；产品设计流程包括多项目晶圆实验流片（MPW）、工程批流片和风险批流片等主要步骤。整体上，公司技术研发和产品开发设计过程既相互衔接又相互交织，构成了公司产品复杂的研发设计过程。

问：公司的营业收入是多少？

肖东戈：报告期内，公司营业收入分别为 50375.98 万元、71579.03 万元和 77253.69 万元。

问：公司的研发费用是多少？

肖东戈：报告期内，公司研发费用分别为 2162.27 万元、3283.88 万元和 3449.53 万元，占营业收入的比例分别为 4.29%、4.59% 和 4.47%，整体保持稳定。

行业篇

问：公司所处什么行业？

朱袁正：根据《国民经济行业分类》（GB/T4754-2017），公司所处行业属于“C39 计算机、通信和其他电子设备制造业”大类下“3972 半导体分立器件制造”；根据《上市公司行业分类指引》（2012 年修订），公司所处行业为“C39 计算机、通信和其他电子设备制造业”。

问：请介绍半导体分立器件行业的发展现状。

朱袁正：分立器件行业是半导体产业中的一个重要分支。据国家统计局数据显示，近几年来，分立器件行业规模以上企业主营业务收入占半导体行业规模以上企业主营业务收入的比重维持在 22% 到 25% 之间。半导体分立器件是电力电子产品的基石之一，也是构成电力电子变化装置的核心器件之一，主要用于电力电子设备的整流、稳压、开关、变频等，具有应用范围广、用量大等特点，在消费电子、汽车电子、电子仪器仪表、工业及自动控制、计算机及周边设备、网络通讯等众多国民经济领域均有广泛的应用。从细分市场来看，半导体分立器件受益于智能制造、电力改造、电子通讯升级、互联网等普及趋势，逐步向高端市场推进。近年来，受益于国际电子制造产业转移，以及下游行业需求拉动，我国半导体分立器件行业保持了较快的发展态势。

目前，我国已经成为全球最重要的半导体分立器件制造基地和全球最大的半导体分立器件市场。据中国半导体行业协会统计，2017 年我国半导体分立器件市场规模已达到 2473.9 亿元，2018 年我国半导体分立器件全年销售规模为 2658.4 亿元，较

2017 年增长 7.50%。从技术发展水平来看，目前国内半导体分立器件行业的整体技术水平仍与国际领先水平存在一定的差距。但随着国家鼓励政策的大力扶持、半导体分立器件国产化趋势显现，以及下游应用领域需求增长的拉动，我国半导体分立器件行业蕴含着巨大的发展契机。

问：半导体分立器件行业的发展趋势是怎样的？

朱袁正：半导体分立器件行业的发展趋势将呈现以下特点：1) 行业集中度提升，呈现外延式发展趋势；2) 替代外贸同类产品市场空间巨大；3) 模块化、集成化的行业技术发展趋势；4) 国内半导体材料有望实现突破。

问：半导体分立器件行业发展的有利因素有哪些？

朱袁正：有利于半导体分立器件行业发展的因素有：1) 国家产业政策大力支持；2) 下游行业市场需求广阔；3) 行业整体技术水平不断提升；4) 进口替代效应不断凸显。

发展篇

问：公司的发展战略是什么？

朱袁正：作为国内半导体功率器件领先企业，公司将依托国家对半导体等战略新兴产业发展的战略支撑，专注于中高端半导体功率器件和模块的研发设计及销售。在保持 MOSFET 产品技术和市场优势基础上，公司将不断引进各类管理、技术、营销人才，构建高效、现代化的经营管理体系，进一步拓展 MOSFET 产品、重点深化 IGBT 产品，成为国内自主创新、技术领先、品质高端的自主品牌优质企业。同时，公司将进一步拓展芯片加工产业，持续整合半导体功率器件封装测试环节垂直产业链，掌控先进半导体功率器件封装产线并布局 SiC/GaN（碳化硅/氮化镓）宽禁带半导体功率器件，进一步强化企业核心竞争力，加快发展成为国际一流的半导体功率器件企业。

问：请介绍公司的产品开发与技术创新计划。

朱袁正：1) 丰富现有系列产品规格型号，拓展市场应用领域范围。在目前多产品系列基础上，公司未来将继续丰富现有产品系列规格型号，加大市场开拓，加强与客户沟通，在既有工艺平台上加大市场高需求产品的研发投入，从而提升盈利能力和抗风险能力。

2) 加快产品升级换代和新产品开发，提高公司产品核心竞争力。基于电荷平衡技术的 MOSFET 和 IGBT 工艺和产品设计，是全球半导体功率器件细分行业最新的技术。公司产品基于该技术，公司将不断加大器件设计和生产工艺平台的研发投入，保持并扩大在超低功耗电荷平衡技术优势下对产品进行升级换代。同时，公司逐步规划国际先进的超薄芯片 FS-IGBT 产品技术、半导体功率器件集成技术、大功率模块封装技术等，迅速实现新技术产品的商业化，不断提升公司产品核心竞争力。

3) 建设研发中心，提高公司研发能力和技术创新能力。为了进一步加强技术创新能力，加快技术突破和新产品开发进度，公司将建设研发中心，购置国际先进半导体功率器件研发设备，配套半导体功率器件研发软件设施，提高在半导体功率器件设计、工艺检测、可靠性评估、失效分析、系统评估、客户应用等方面的综合能力，提升公司的研发能力和技术创新能力。

4) 加强产学研合作，加快半导体功率器件研发成果产业化。为了紧跟国际最新半导体功率技术，提前布局下一代半导体功率器件产品，公司一方面不断通过外部引进和自主培养等方式培育高端技术人才，另一方面将进一步巩固与科研院所的产学研合作关系，利用江苏省企业研究生工作站平台，提高半导体功率器件的研发成果转化效率，加快研发成果转化进度，为公司长期发展打下基础。

问：请介绍公司的市场开拓与宣传建设计划。

朱袁正：1) 巩固现有客户和市场，提高市场的供应份额。公司未来将不断增强市场营销团队力量，在加强与现有重点客户合作关系基础上，通过参加展会或论坛、企业招标、重点客户拜访等方

式，不断巩固现有产品下游领域，提高市场占有率。2) 拓展产品应用领域，继续扩大市场份额。未来，公司一方面将不断拓展其他领域的客户，扩大多个下游市场的开发；另一方面，公司将通过丰富现有产品系列型号、对现有产品升级换代和新技术新产品开发等方式，满足其他应用领域客户的多方面需求。此外，公司将深化半导体功率器件在系统层面的应用特性分析，为客户提供整体解决方案，加快客户在使用公司产品时的研发、测试、评估进度，快速拓展公司产品的应用领域。

3) 加强产品宣传，树立公司中高端产品品牌形象。公司今后将完善品牌建设，进一步加强市场宣传力度，拓展营销与服务网络覆盖的深度和广度，增强客户服务能力和响应速度，不断树立公司中高端半导体功率器件品牌形象。

问：公司的竞争优势有哪些？
朱袁正：公司的竞争优势包括：1) 研发实力优势；2) 产品系列优势；3) 产品质量优势；4) 产业链协作优势；5) 下游应用优势；6) 进口替代优势；7) 品牌和客户优势；8) 人才优势。

发行篇

问：公司的实际控制人是谁？

肖东戈：朱袁正为公司实际控制人，直接持有公司 31.11% 的股权。同时，朱袁正与叶鹏、戴锁庆、周洞源、王成宏、顾朋朋、吴国强、李宗清、王永刚、陆虹、肖东戈共 10 名股东分别签订有关一致行动的协议，约定上述 10 名股东在公司股东大会或董事会表决时，应主动与朱袁正保持一致。因此，朱袁正可控制的股权比例为 35.62%。

问：公司持股 5% 以上股份的主要股东有哪些？

肖东戈：截至招股书签署日，持有公司 5% 以上股份的股东为朱袁正、达晨创投、上海贝岭、国联创投、金浦创投。

问：此次发行数量是多少？

陈拥军：公司本次拟公开发行股票不超过 2530 万股，不低于发行后总股本的 25%。本次发行全部为新股发行，原股东不公开发售股份。

问：本次发行的募集资金用途有哪些？

盛金龙：本次发行募集资金扣除发行费用后，将主要用于“超低功耗高可靠性半导体功率器件研发升级及产业化项目”“半导体功率器件封装测试生产线建设项目”“碳化硅宽禁带半导体功率器件研发及产业化项目”“研发中心建设项目”及“补充流动资金”。

问：请介绍建设超低功耗高可靠性半导体功率器件研发升级及产业化项目的必要性及可行性。
肖东戈：建设该项目的必要性有：1) 满足蓬勃发展的下游应用市场需求；2) 持续技术创新、保持市场竞争力的需要；3) 进军高端市场，打破国外企业在高端应用领域的垄断地位。

建设该项目的可行性有：1) 顺应行业发展趋势，符合国家产业政策；2) 充足的研发人才及技术储备为项目实施提供必要基础；3) 下游应用优势和客户资源保障项目产能消化；4) 产业链协作优势为项目实施提供有力支持。

问：请介绍建设封装测试生产线建设项目的必要性及可行性。

肖东戈：建设该项目的必要性有：1) 把控产品质量、进军高端市场的需要；2) 提升产品性能、增强市场竞争力的需要；3) 控制封装成本、加强技术保密的需要。

建设该项目的可行性有：1) 国家产业政策提供了良好的发展环境；2) 充足的技术储备和研发能力夯实了项目实施的基础；3) 研发人才和管理人才为生产建设和运营提供保障。

问：请介绍建设碳化硅宽禁带半导体功率器件研发及产业化项目的必要性。

肖东戈：建设该项目的必要性有：1) 顺应行业发展趋势，实现产品结构升级的需要；2) 把握市场机遇，巩固公司国内领先地位的需要；3) 缩小与国际先进水平差距，提高国际竞争力的需要。